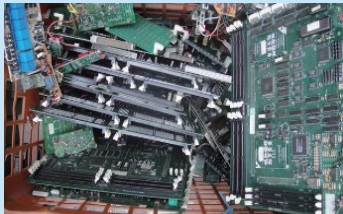
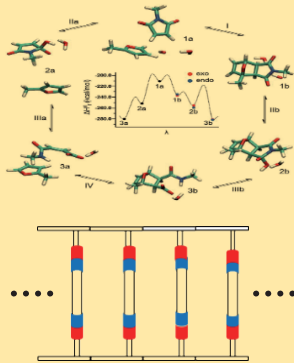


可循環熱固技術是PCB材料世界的未來

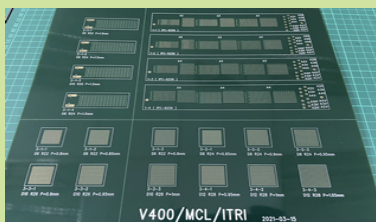
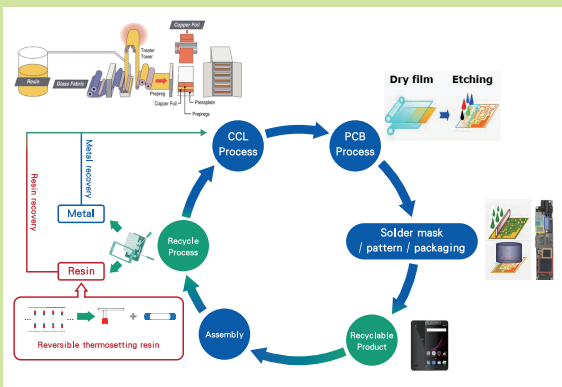
工研院開發可循環熱固樹脂，可取代傳統環氧樹脂，本技術利用熱解鏈方式多次循環利用，降低碳排及減少電子廢棄物產生。



- 國內相關產業每年釋出之廢棄物(Waste)達30萬噸以上。
- 歐盟循環經濟政策中，在2030年時電子廢棄電子產品需能做到原物料再回收>70%。



- 調整不同高分子化學結構基，提高可逆溫度至 $\geq 300^{\circ}\text{C}$
- 樹脂回收率>85%
- 樹脂本身可重複回收次數大於6次
- 可回收基板樹脂具有良好絕緣性，通過大於1000h CAF test(85°C , 85%, 50V)



Items	日本M公司	MCL
T _g (°C)	175	> 200
CTE (ppm/°C)	50	< 50
T _d (°C)	350	> 400
DK@10 GHz	4.1	3.9
Df@10 GHz	0.015	0.009
T-288 (min)	> 60	> 60
Flammability	V0	V0